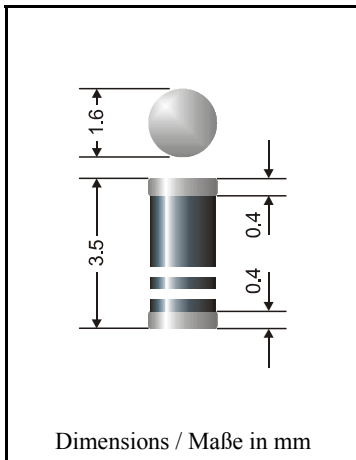


**Ultrafast Switching  
Surface Mount Si-Rectifiers**

**Ultraschnelle Si-Gleichrichter  
für die Oberflächenmontage**



Nominal current – Nennstrom	0.5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...400 V
Plastic case MiniMELF Kunststoffgehäuse MiniMELF	SOD-80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform getupet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

- Marking: 1. green ring denotes “cathode” and “ultrafast switching device”  
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
- Kennzeichnung: 1. grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “ultraschneller Gleichrichter”  
2. farbiger Ring kennzeichnet “Period. Spitzensperrspannung” (siehe unten)

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Rep. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspanng. $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	2. Cathode ring 2. Kathodenring
EGL 34A	50	50	gray / grau
EGL 34B	100	100	red / rot
EGL 34D	200	200	orange
EGL 34G	400	400	yellow / gelb

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 75^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	0.5 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	10 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	0.5 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	– 50...+175°C – 50...+175°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit $t_{rr}$ [ns] <sup>1)</sup>	Forward voltage Durchlaßspannung $V_F$ [V] at / bei $I_F$ [A]
EGL 34A ... EGL 34D	< 50	< 1.25      0.5
EGL 34G	< 50	< 1.35      0.5

Leakage current  
Sperrstrom

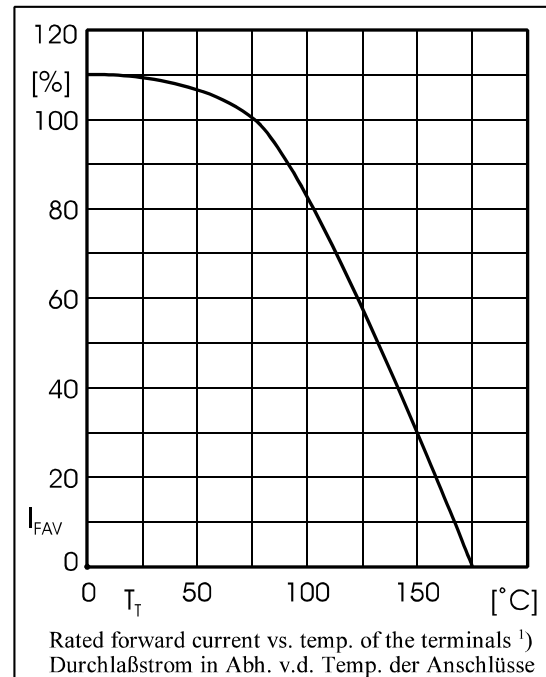
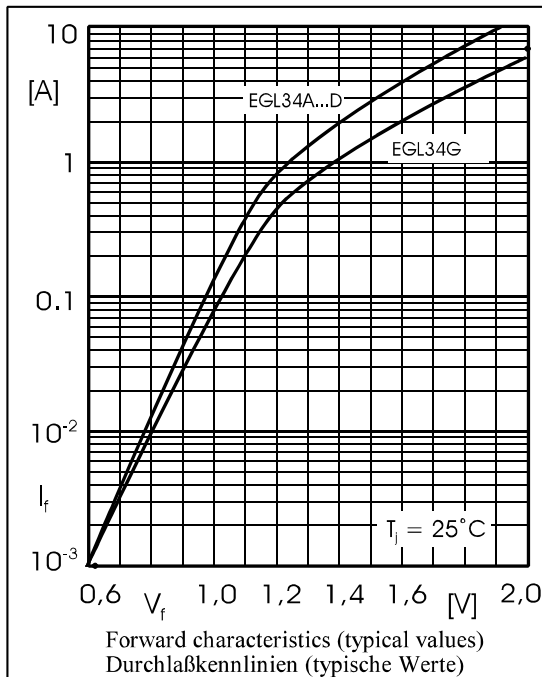
$T_A = 25^\circ\text{C}$        $V_R = V_{RRM}$        $I_R < 5 \mu\text{A}$   
 $T_A = 125^\circ\text{C}$        $V_R = V_{RRM}$        $I_R < 50 \mu\text{A}$

Thermal resistance junction to ambient air  
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

$R_{thA} < 150 \text{ K/W}^2)$

Thermal resistance junction to terminal  
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

$R_{thT} < 70 \text{ K/W}$



<sup>1)</sup>  $I_F = 0.5 \text{ A}$  through/über  $I_R = 1 \text{ A}$  to/auf  $I_R = 0.25 \text{ A}$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß